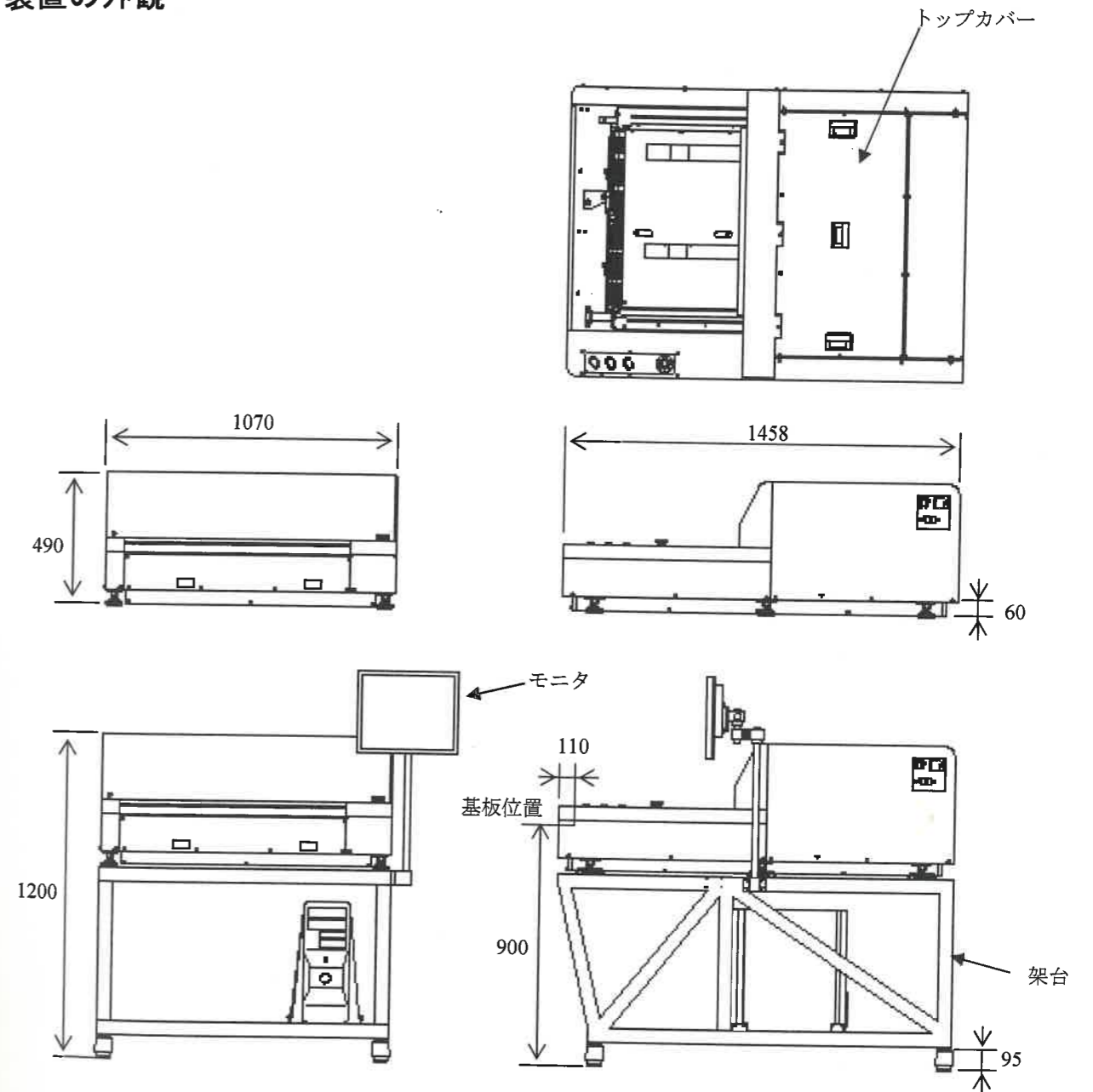


1. 概要

本装置は、フローはんだおよびリフローはんだ装置によりはんだ付けされた基板のはんだ付け状態や実装状態(S)をあらかじめ作成してある“検査プログラム”にもとづいて検査する装置です。検査には、カラーハイライト法による独自の画像処理技術を用いています。検査結果はモニターやプリンタに出力されます。

2. 装置の外観



(単位: mm)

* 本図の寸法は、ネジ等の突起物を除いたものです。